

電子機器用・通信機器用部品製造業における通路を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
2	5~6	出社時、会社駐車場内を玄関に移動中、凍結路面で足をとられ、尻もちをつき仰向けの状態で後頭部を強打する形で転倒した。	52	30~49
3	15~16	旧工場から新工場へ走りながら移動している際、通路の段差につまずき転倒し、手をついた時の衝撃と肩を地面にぶつけたことで負傷した。	46	—
3	12~13	被災者は、派遣先にて子基盤のハンダ付け業務に就いていた。クリーンルーム内で会社指定の静電靴をはいて作業していた際、静電靴をはいて廊下を歩いていたとき、靴の底が滑りにくいため床の摩擦で引っかかり転倒しそうになった。とっさに壁に左手をついて転倒を防ごうとしたが、勢いが強かったためそのまま左肩を脱臼した。	43	100~299
7	13~14	部材置場の表示板位置を直し終えて部材が置いてある場所から移動しようとした時、パレットに足が引っかかり転んで床に手をついたら右肩を脱臼骨折した。	50	500~999
9	14~15	当社作業場内において、パワーリフトを移動させようと引っ張ったときに、後ろに置いてあった箱に足が当たり、後ろに転倒し尻餅をついたときに負傷した。しばらくすれば痛みが引くだろうと自宅静養していたが、なかなか痛みが引かないため受診した。	58	30~49
10	12~13	当社工場内において、始業時（当人は午後勤務）に作業場に向かって早足で歩いているとき、通路上で方向転換（左折）しようとしたところ、右足をくじき、甲の骨を剥離骨折した。（通路上に障害物や段差はなく、水平だった。）	57	50~99
11	3~4	工場内で、スモッグルーム出入口下駄箱で靴に履き替えていた。靴を履ききっていないにもかかわらず、脇見をして、左足を踏み出し右足を踏み出した時、バラ	61	100~

		ンスを崩して転倒し負傷した。		299
11	16~ 17	半導体製造工程において、作業終了後、建屋1F出入口より退出しようとしたところ、玄関滑り止めマットに躓き前のめりになり転倒し、1F出入口下り階段の角に右膝を強打し負傷した。	53	500 ~ 999
12	21~22	会社敷地内の駐車場で帰宅途中に、路面が凍結しており足を滑らせ転倒し左上腕を骨折した。	41	—
12	8~9	オフィス内にて、朝のラジオ体操を行っていた際、周囲の人と手が当たりそうになったため、体操をしながら横に移動した際、椅子の脚に引っ掛け転倒し、受傷した。	56	1000 ~ 9999

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html